



PRIORTECH

מצגת שוק הון
מאי 2024



הערות משפטיות

מטרת מצגת זו לספק אינפורמציה בלבד בנוגע לחברת פריורטק בע"מ ("החברה") ו/או החברות המוחזקות שלה.

מצגת זו אינה מהווה, ואין לפרשה, כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה, או כהזמנה לקבל הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. כמו כן, מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות ערך של החברה או איזה מהחברות המוחזקות שלה. המידע הנכלל במצגת אינו מהווה ייעוץ, המלצה, חוות דעת או הצעה באשר לכדאיות השקעה ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של החברה.

המצגת כוללת נתונים ומידע המוצגים באופן ובעריכה שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים הפומביים או ככזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחים הפומביים. על כן, מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ובכלל זה, בתשקיף מדף, בדוחותיה העיתיים של החברה או בדיווחיה המיידים של החברה. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה של החברה יגבר האמור בדיווחים האמורים.

מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, אומדנים, כוונות ונתונים נוספים המתייחסים לאירועים עתידיים המהווים "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בסעיף 32א בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, המבוסס על תחזיות, ציפיות והנחות סובייקטיביות כפי שידועות לחברה במועד הכנת מצגת זו. ההערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, ויכול שתושפענה מגורמים שאינם בשליטת החברה ושלא ניתן להעריכם מראש באופן סביר במועד, לרבות אבל לא רק, בשל: (א) האטה בצמיחה הכלכלית ככלל והאטה בפעילות בשווקי האלקטרוניקה והשבבים בפרט, עיכובים בשרשרת האספקה ועליות מחירי הובלה, עליות במחירי חומרי גלם, הפרעות ועיכובים בהתקנות של המוצרים באתרי לקוחות, עיכובים והפרעות לתהליכי ייצור, שיווק ומחקר ופיתוח, וכן הפרעות ועיכובים בייצוא או ייבוא של רכיבים ומוצרים, בין השאר בשל הטלת מגבלות תנועה וסגרים בטריטוריות בהן פועלות החברה ו/או החברות המוחזקות שלה; (ב) תלות בצדדים שלישיים וקיום הסכמים על ידי צדדים שלישיים עימם התקשרה החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות שלה; (ג) התפתחויות רגולטוריות ומדיניות ממשלתית, בעיקר בשל פעילותן חברות הקבוצה בטריטוריות ברחבי העולם ובעיקר במזרח אסיה; (ד) חוסר יציבות באזורי פעילות גלובלית והשפעת משברים פוליטיים, כלכליים וגאו-פוליטיים על תעשיית המוליכים למחצה והמתח בין ארה"ב לבין סין; (ה) ההיצע העולמי של רכיבים אלקטרוניים ויכולתן של החברות המוחזקות לרכוש רכיבים אלקטרוניים לצורך שימור היתרון התחרותי שלהן; (ו) גידול בעלויות תפעוליות; (ז) עליות ייצור גבוהות של לקוחות אשר עלולות להביא לעיכוב ברכישת מוצרים של החברות המוחזקות; (ח) גורמי הסיכון המפורטים בדוח השנתי של החברה לשנת 2023 שפרסמה החברה ביום 26 במרס, 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-025957).

לפיכך, תוצאות או ביצועים עתידיים בפועל של החברה או החברות המוחזקות שלה עשויים להיות שונים מהותית מכפי שנצפה או כפי שמתפרש במצגת זו.

למעט כפי שיידרש על פי דין, החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות מצגת זו ו/או לעדכן ו/או לשנות נתונים ו/או תחזיות ו/או הערכות שנכללו בה על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

חלק מהמידע הכלול במצגת (כולל שווקים ומגמות) מבוסס או נגזר מנתונים שהחברה אספה מצדדים שלישיים בלתי תלויים שהחברה אינה יכולה לערוך לנכונותם היות ולא בדקה את הנתונים בעצמה.

כמו כן, מובהר כי אין בביצועי העבר של החברה ו/או החברות המוחזקות שלה המוצגות במצגת זו כדי להוות אינדיקציה לתוצאות העתיד ואין כל וודאות כי החברה ו/או החברות המוחזקות שלה יגיעו לתוצאות דומות או יוכלו ליישם את אסטרטגיית ההשקעה שלהן או להשיג כל יעד השקעה.

מונחים מקצועיים

הגדרות

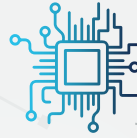
(HPC) High Performance Computer

מחשבים חזקים במיוחד כדי לפתור בעיות חישוב מתקדמות, המתבססים על מארזים מתקדמים מסוג Chiplet או Heterogeneous Integration (HI) שתומכים בישומי AI וכוללים זיכרונות DRAM מסוג HBM שהם 8 שכבות של ציפים מסוג Dram שמורכבים אחד על השני, חברת TSMC פיתחה מארז בשם CoWoS, בתעשייה משתמשים בשם זה במקום HI.



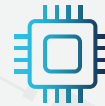
(HI) Heterogeneous Integration

אינטגרציה של רכיבי סמיקונדקטור המיוצרים בנפרד במכלול ברמה גבוהה יותר, אשר, במצטבר, מספקת פונקציונליות משופרת ומאפייני פעולה משופרים.



Chiplet

ציפלט הוא יחידת עיבוד משנית, הנשלטת בדרך כלל על-ידי בקר קלט/פלט הנמצא באותו מארז. ארכיטקטורת הציפלט היא גישה מודולרית לבניית מעבדים. יצרני המעבדים המובילים בעולם, מאמצים את ארכיטקטורת הציפלט לקו המוצרים הנוכחי שלהם.



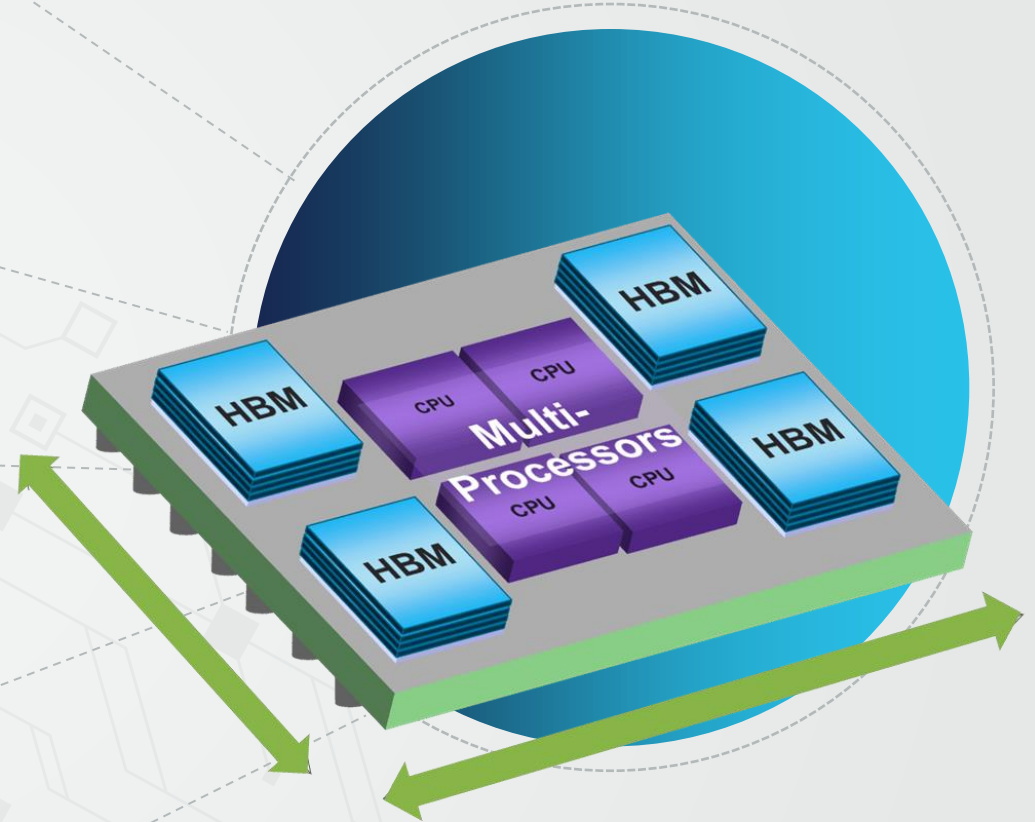
(HBM) High Bandwidth Memories

זיכרון רחב פס גבוה, הוא ממשק זיכרון מחשב מהיר עבור זיכרון דינמי מוערם בתלת-ממד.



FC-BGA

מערך כדורי על מצע אורגני לאריזת מוליכים למחצה בצפיפות גבוהה, המאפשר יותר פונקציות לשבבי LSI במהירות גבוהה.





PRIORTECH

תוצאות Q1-24

Y 2023

\$27.2M

Q1-24

\$8.6M

רווחי
אקויטי

Y 2023

\$26.1M

Q1-24

\$8.1M

רווח
נקי

חוב פיננסי, נטו

\$33.2M

הון עצמי

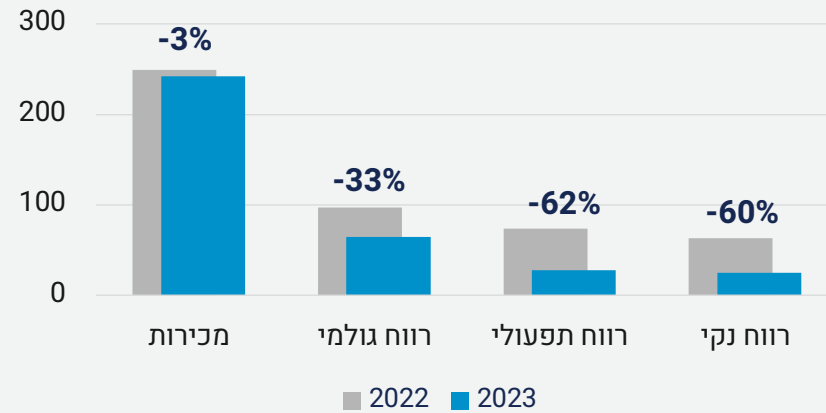
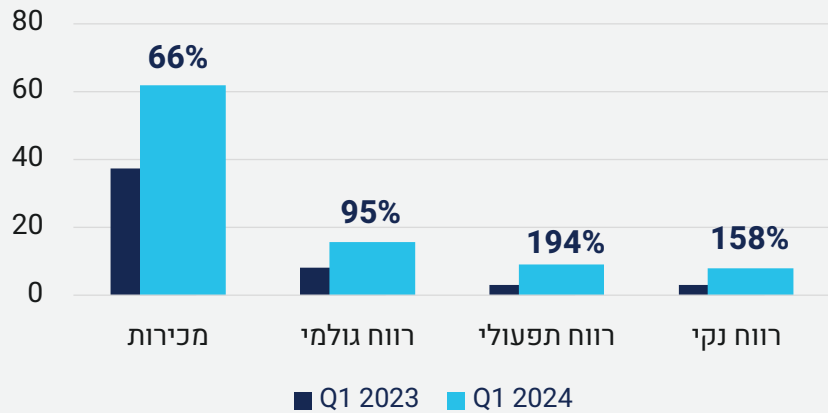
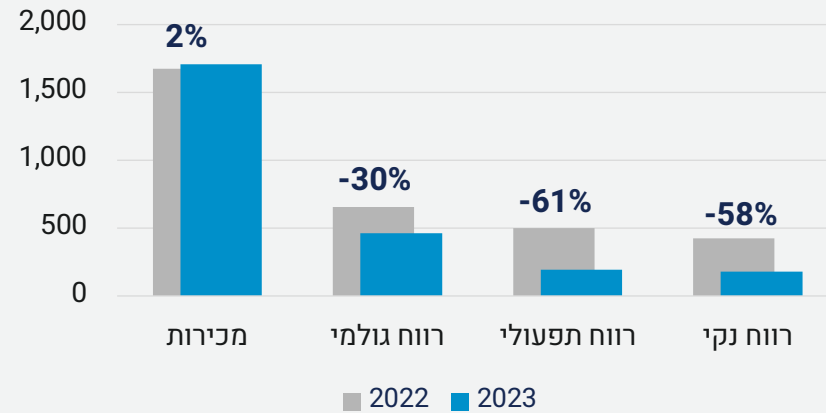
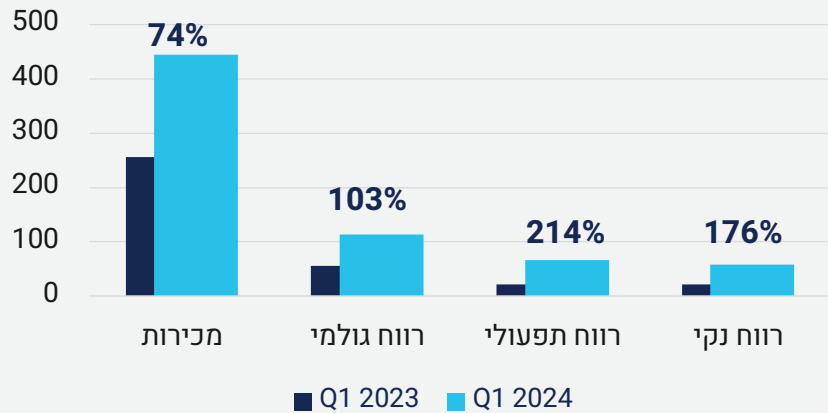
\$240M



 **ACCESS**

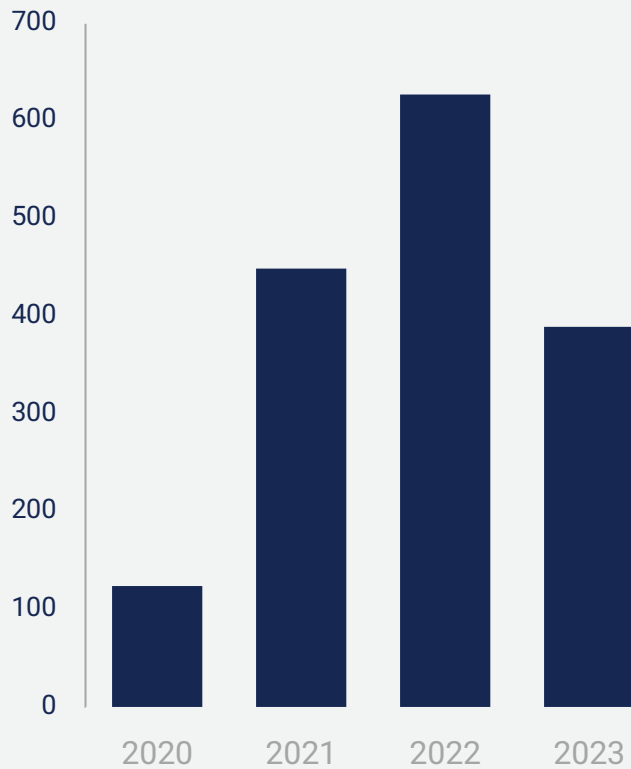
AMITEC/ACCESS

אקסס – תוצאות רבעון ראשון 2024

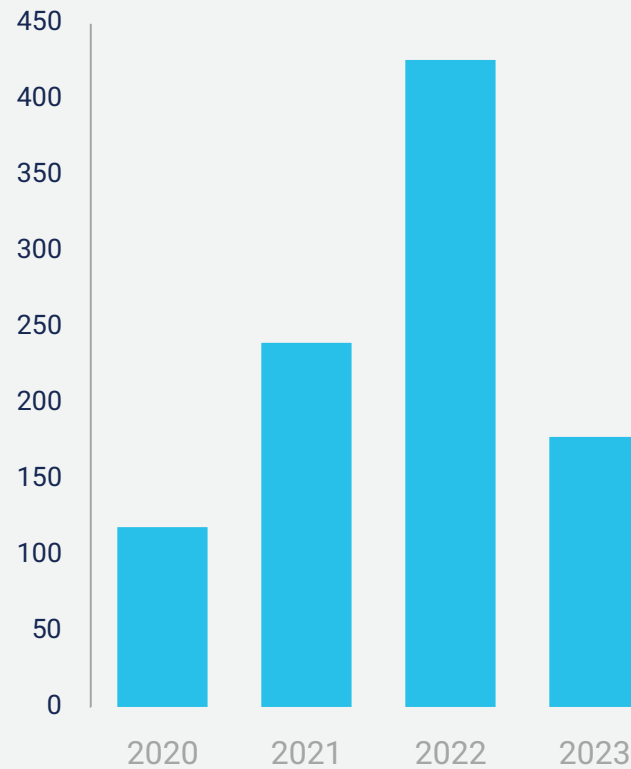


אקסס - תוצאות שנתיות 2020-2023 (RMB M)

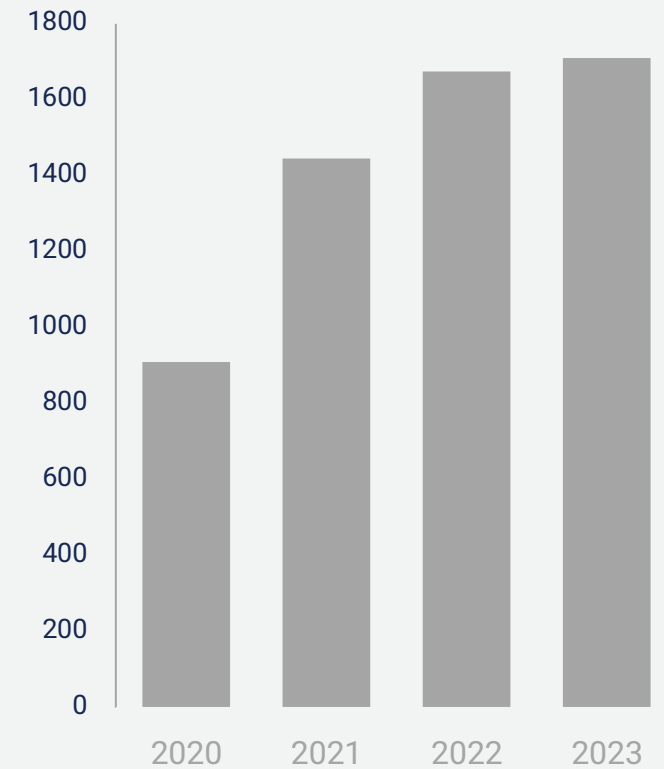
EBITDA



Net Profit

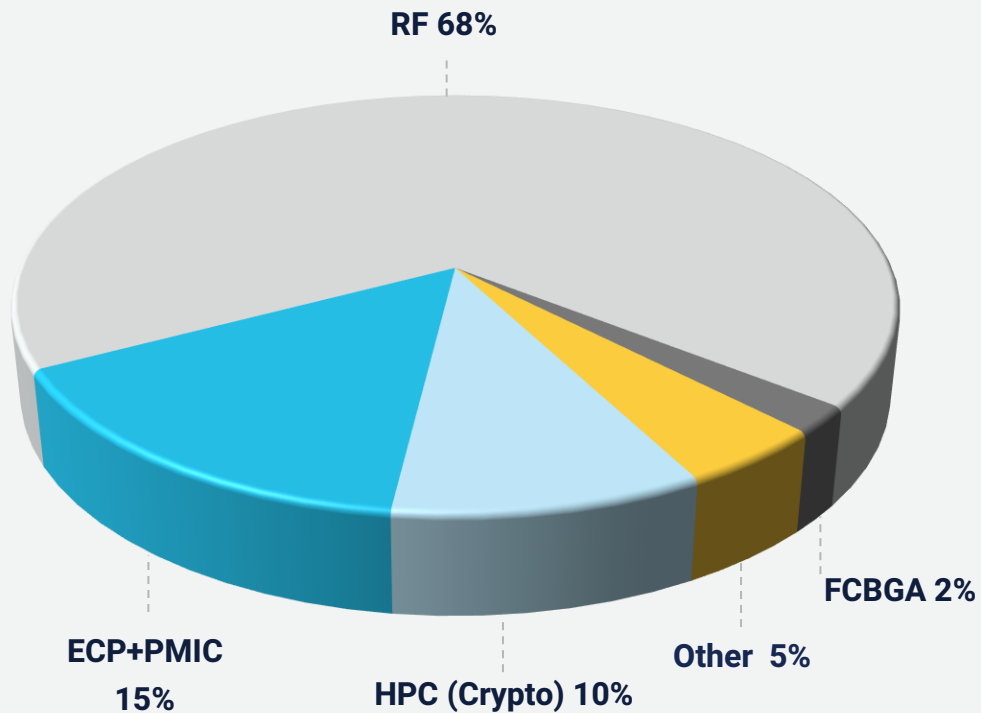


Sales

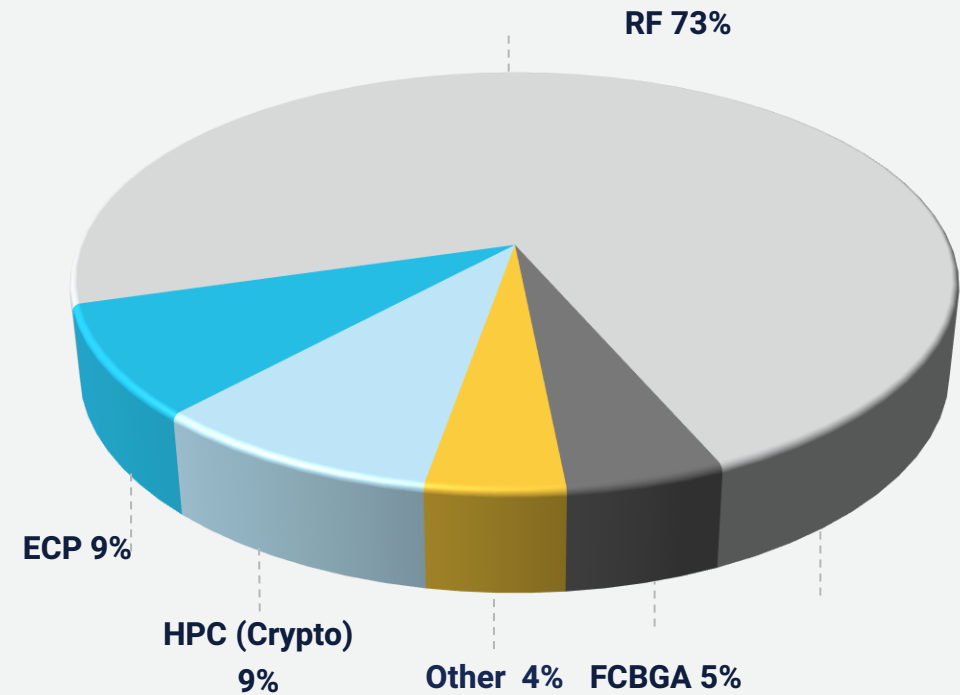


התפלגות סל המוצרים

Q1 2024 REVENUE



Q4 2023 REVENUE



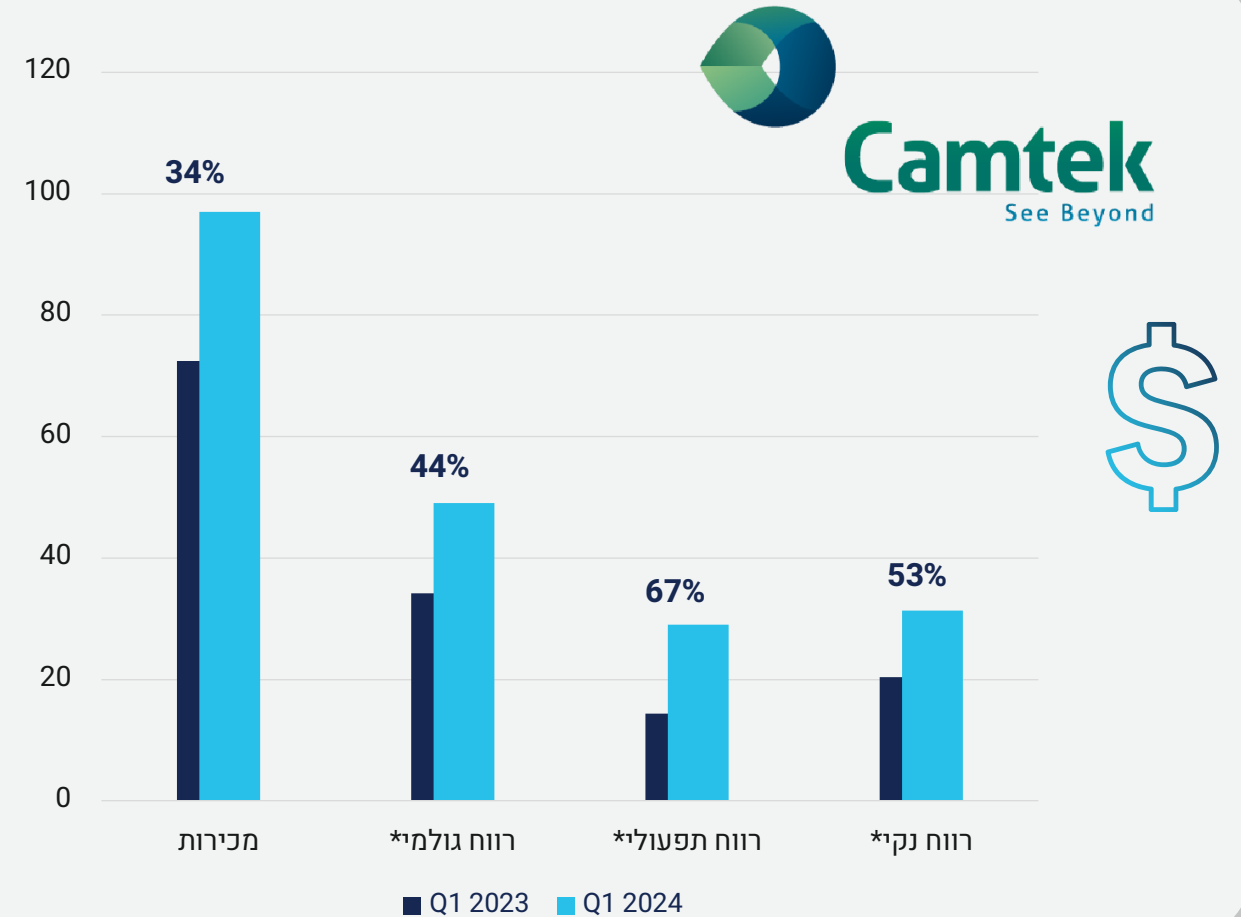
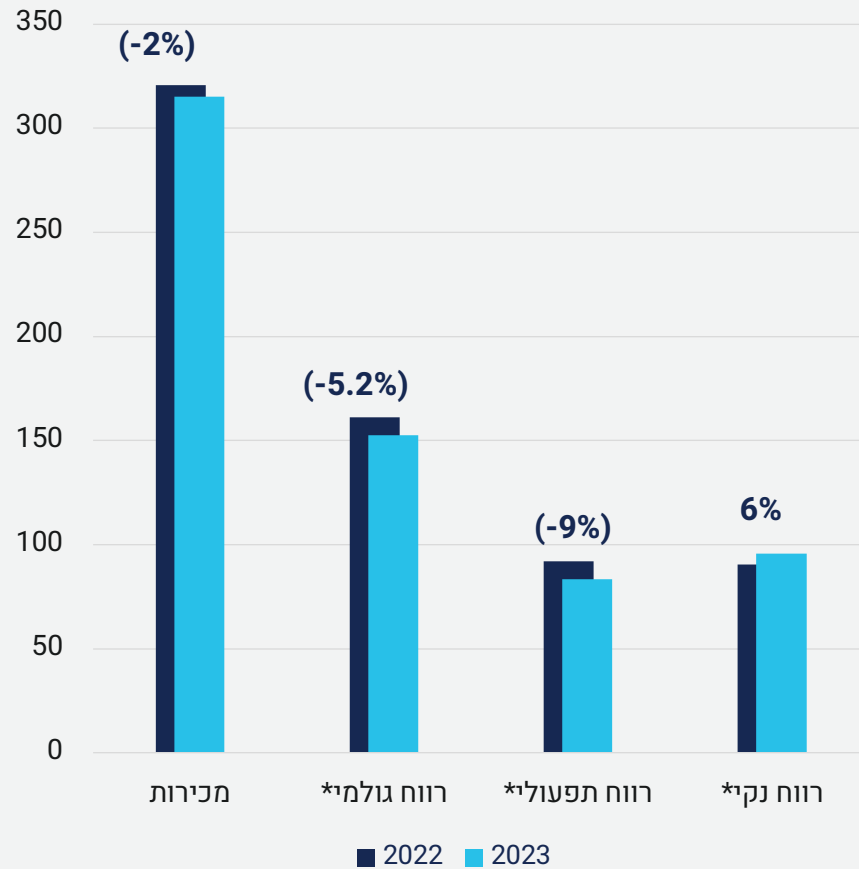
Camtek



CAMTEK



קמטק תוצאות רבעון ראשון 2024 עם השוואה בין רבעונים ושנים



תחזית שוק הסמיקונדקטור

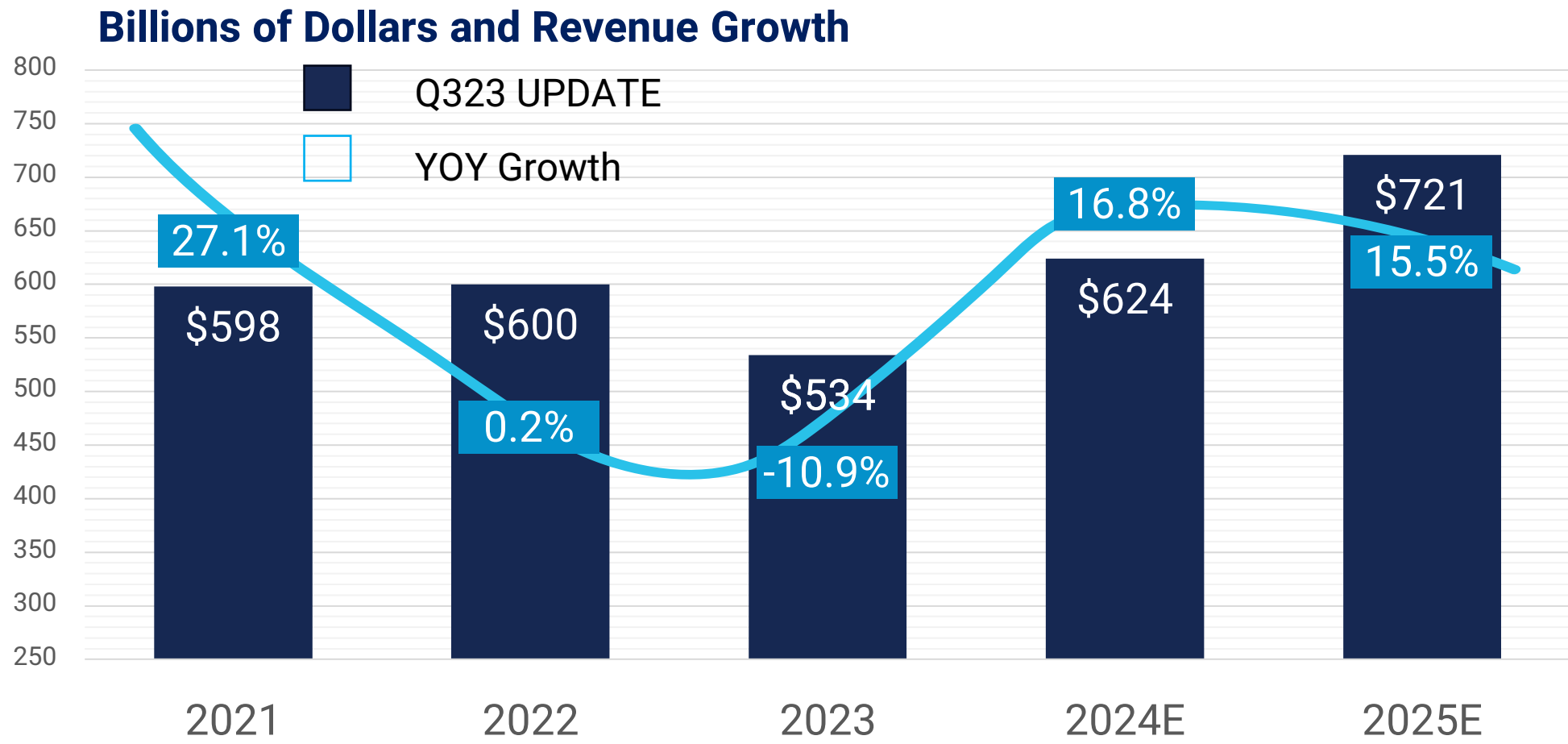
שוק הסמיקונדקטור, אשר סבל מירידה במכירות הגלובליות בשנת 2023, **מגלה סימני התאוששות בעיקר בגלל הביקוש לרכיבים שתומכים באפליקציות ל-AI**, הערכות האנליסטים בשוק צופות גידול של כ-13%-17% בשנת 2024 וגידול דומה בשנת 2025.

הניצולת בפאבים ברחבי העולם, שלא מייצרים רכיבים עבור HPC, עדיין נמוכה מזו שהייתה בשנת 2022.

המכירות הצפויות של מוצרי הקצה (המשתמשים ברכיבים אלקטרוניים) **מתאוששות בשנת 2024**, לרבות מכירות הטלפונים הסלולריים, המהווים נתח נכבד מהביקוש לרכיבים בשוק הסמיקונדקטור.

הביקושים למארזים מסוג CoWos המכילים רכיבים מסוג Chiplet and HBM ומיועדים למוצרי AI/ HPC **צפויים להיות מנוע הצמיחה העיקרי של השוק.**

שוק הסמיקונדקטור במגמת גידול



Expects to Reach
\$1 Trillion
in 2030



תיאור המצב העסקי של החברות הכלולות

מצב שוק הסמיקונדקטור בשנת 2024

עבור קמטק ואקסס

אנליסטיים מעריכים שתעשיית הסמיקונדקטור תמשיך לגדול בשנים הקרובות ותגיע להיקף מכירות של טריליון דולר עד סוף העשור.

שוק הסמיקונדקטור נחלש בשנת 2023 בהשוואה לשנת 2022 שהייתה שנת שיא לתעשייה. אנליסטים מעריכים שנראה מגמה של גידול בשנת 2024. קמטק פרסמה תחזית מכירות של 100-102 מיליון דולר ברבעון השני של 2024 – צמיחה של 37% לעומת הרבעון המקביל. אקסס צופה יציבות במכירות בשנת 2024 לעומת 2023.



הגידול בביקוש למארזים מסוג (AI applications) HBM and Chiplet – מהווים עבור קמטק הזדמנות להמשיך צמיחה, גם אקסס נהנית מהגידול בביקושים ל HPC, אקסס מוכרת מצעים מסוג PMIC עבור תחום זה.



קמטק מעריכה **ששנת 2024 תהיה שנת שיא במכירות**, בה תהנה מביקושים ערים מיצרני רכיבי HBM ו-Chiplet עבור יישומי AI.



החולשה הכלכלית בסין משפיעה כמובן גם על אקסס, אולם, כתוצאה מהמאמצים של תעשיית הסמיקונדקטור בסין להתחרות עם ייבוא רכיבים ולהגדיל את ניצולת הפאבים שלהם, אקסס מצליחה לשמור על קצב מכירות הדומה לזה שהיה בשנתיים האחרונות. גם הנהלת קמטק וגם הנהלת אקסס מעריכות שנראה שיפור בביקושים בסין בחצי השני של 2024.



אקסס מעריכה שהיא תשמור לפחות על רמת מכירות דומה לזו שב 2022 ו 2023 (סביב ה 250 מיליון דולר) וזאת למרות שסין עדיין נמצאת בהאטה כלכלית. הגורם שמאזן את ההאטה הכלכלית בסין הוא שתעשיית הסמיקונדקטור בסין משקיעה מאמצים ניכרים להחליף ייבוא רכיבים מחו"ל.

הרווחיות של פאב A ופאב C ברבעון הראשון של 2024 הייתה טובה והנהלת אקסס מעריכה שהיא תצליח לשמור על רווחיות דומה למשך שנת 2024. פאב B מתנהל עדיין בתפוסה נמוכה בגלל ביקושים נמוכים למוצרי קצה, יחד עם זאת. רוב הבעיות הטכנולוגיות שהיו בייצור מצעי FCBGA נפתרו. ועם השיפור במצב הכלכלי והגדלת הביקושים למוצרי קצה נוכל לראות שיפור בתוצאות של פאב B.

פוטנציאל הצמיחה של אקסס – פוטנציאל הצמיחה של אקסס מורכב מגידול אורגני של המצעים לתחום האנלוגי (RF ו PMIC) תחום שאקסס כבר התבססה בו. וממצעים לתחום הדיגיטלי FCBGA שאקסס נמצאת רק בראשית הדרך עם פוטנציאל גידול גבוה.

**המצעים לתחום ה PMIC מיועדים למחשבי ה HPC לאפליקציית AI.

המצב העסקי של קמטק

קמטק נהנית מביקושים גבוהים למערכות HPC שמשרתות את תחום ה AI, אבני היסוד של ה-HPC הם רכיבים מסוג HBM, מעבדים מסוג צ'יפלט ושילוב שלהם על מצע סיליקון (CoWos).

כל חברות ה memory המובילות מגדילות את כושר הייצור שלהם לייצור רכיבי HBM וגם חברת TSMC מגדילה את כושר הייצור שלה לייצור מארזי CoWos.

כרגע הביקושים גדולים מכושר הייצור ונראה שייקח עוד זמן להדביק את הפער.

לגבי שאר הרכיבים שאינם משרתים את ה HPC, קמטק מעריכה שבחצי השני של השנה נראה גידול בביקושים לסוגים אלו של הרכיבים.



Camtek
See Beyond

פוטנציאל הצמיחה של קמטק – תחום המארזים המתקדמים (Advanced Interconnect Packaging) ימשיך לגדול ולהוות את עיקר המכירות של קמטק, טכנולוגיות חדשות של מארזים מתקדמים ייכנסו לשוק בשנים הקרובות ויחייבו פתרונות Inspection מתקדמים. קמטק תדע לתת פתרונות הולמים.





להערכת החברה, קמטק תמשיך לחזק את מעמדה בתחום ה HPC עבור יישומי AI, אשר צפוי כי ימשיך לצמוח בשנים הקרובות, בקצב שנתי של 20-30%. קמטק גם תמשיך לשרת שווקים נוספים עם פוטנציאל גידול כמו ה compound semi עבור רכיבי Power devices בעיקר לתעשיית הרכבים החשמליים, תחום ה AP בכללותו ושאר השווקים אותם היא משרתת היום.

להערכת החברה, אקסס תמשיך לגדול באופן אורגני בשווקים המסורתיים שלה (RF, PMIC והקריפטו) בנוסף אקסס תמשיך לפתח את התחום הדיגיטלי (FCBGA), הנהלת אקסס מעריכה שהמאמץ שסין עושה לפתח את תעשיית הסמיקונדקטור ולהחליף ייבוא של רכיבים לטובת ייצור מקומי יגרום לביקושים גם למצעים שאקסס מייצרת ויהוו עבודה מנוע גידול.



PRIORTECH

תודה